



Linking your dreams
リンテック株式会社

Creating the Future with Adhesive Technologies

Linkage + Technology

LINTEC

夢をカタチにする粘・接着技術のリンテック

**リンテック株式会社
代表取締役社長
大内 昭彦**

2010.07.10

会社概要

- **本 社** 東京都板橋区
- **証券コード** 7966(東証1部)
- **設 立** 1934年(昭和9年)10月15日
- **資本金** 232億円(10年3月末)
- **従業員数** 4,037人(10年3月末):連結
- **売上高** 1,893億円(10年3月期):連結
- **決算日** 3月31日
- **事業内容** 粘着製品、粘着関連機器、特殊紙、
剥離紙・剥離フィルムなどの開発・製造・販売
- **事業拠点** 国内連結子会社: 4社
海外連結子会社: 17社



1934年
(昭和 9年)

**ガムテープメーカー「不二紙工株式会社」
設立(東京・板橋)**



1960年
(昭和35年)

**シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルムの
製造・販売を開始**

以降、屋内外装飾、二輪・自動車関連などの
工業分野に粘着事業を拡大



1984年
(昭和59年)

**UV硬化型ダイシングテープを開発し、
半導体関連分野に本格参入**

1987年
(昭和62年)

米国のマディコ社を子会社化

1990年
(平成 2年)

**四国製紙、創研化工と合併
「リントック株式会社」に商号変更**

特殊紙、剥離紙・剥離フィルムから粘着紙・
粘着フィルム、関連機器分野にまで業容を拡大



1991年 液晶関連分野に本格参入
(平成 3年)

1993年 琳得科(天津)実業有限公司を設立
(平成 5年)

1994年 リンテック・インドネシア社を設立
(平成 6年)

2000年 リンテック・インダストリーズ(マレーシア)社を設立
(平成12年)

2002年 琳得科(蘇州)科技有限公司を設立
(平成14年)

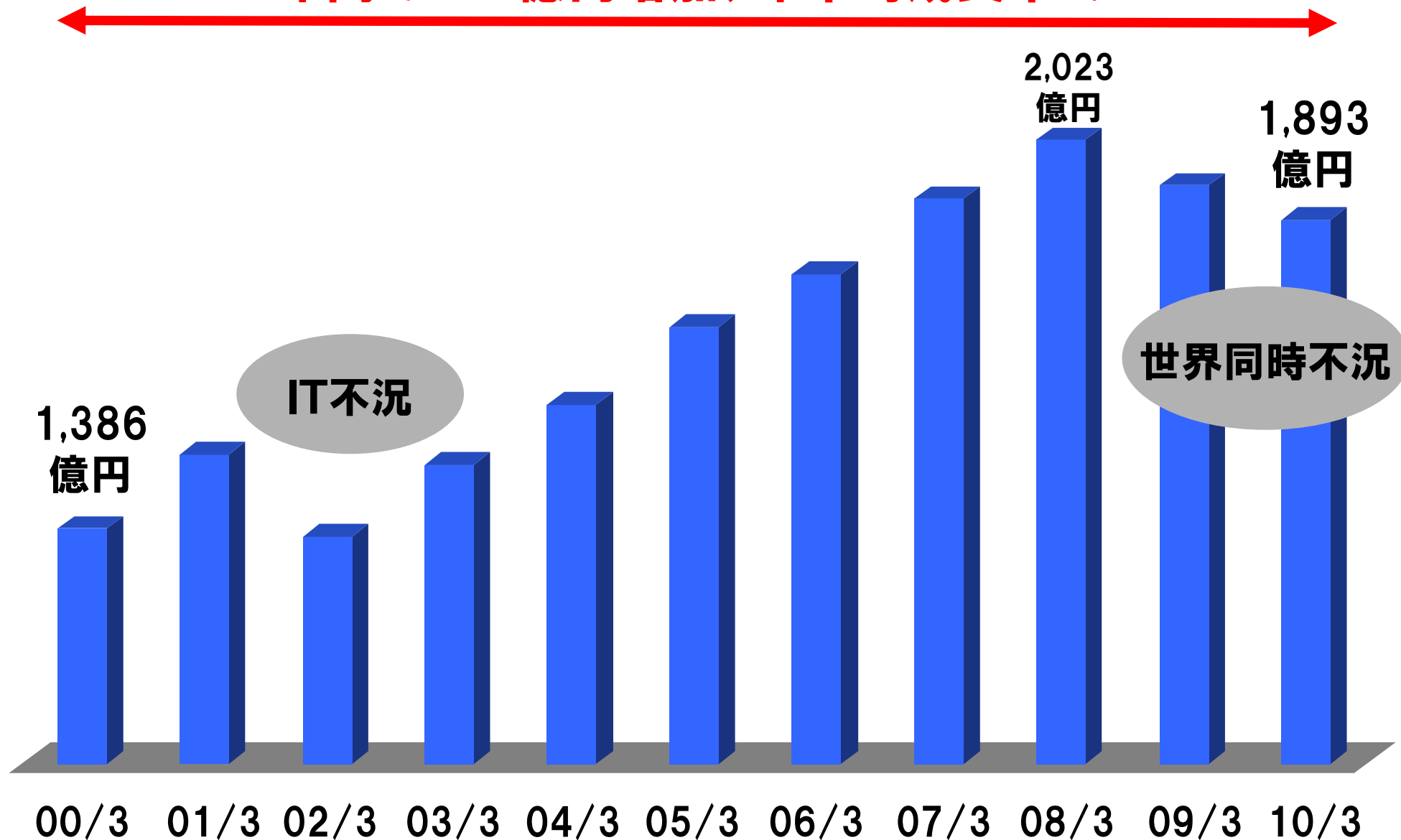
リンテック・スペシャリティー・フィルムズ(韓国)社を設立

2003年 リンテック・スペシャリティー・フィルムズ(台湾)社を設立
(平成15年)

2004年 リンテック・コリア社を設立
(平成16年)

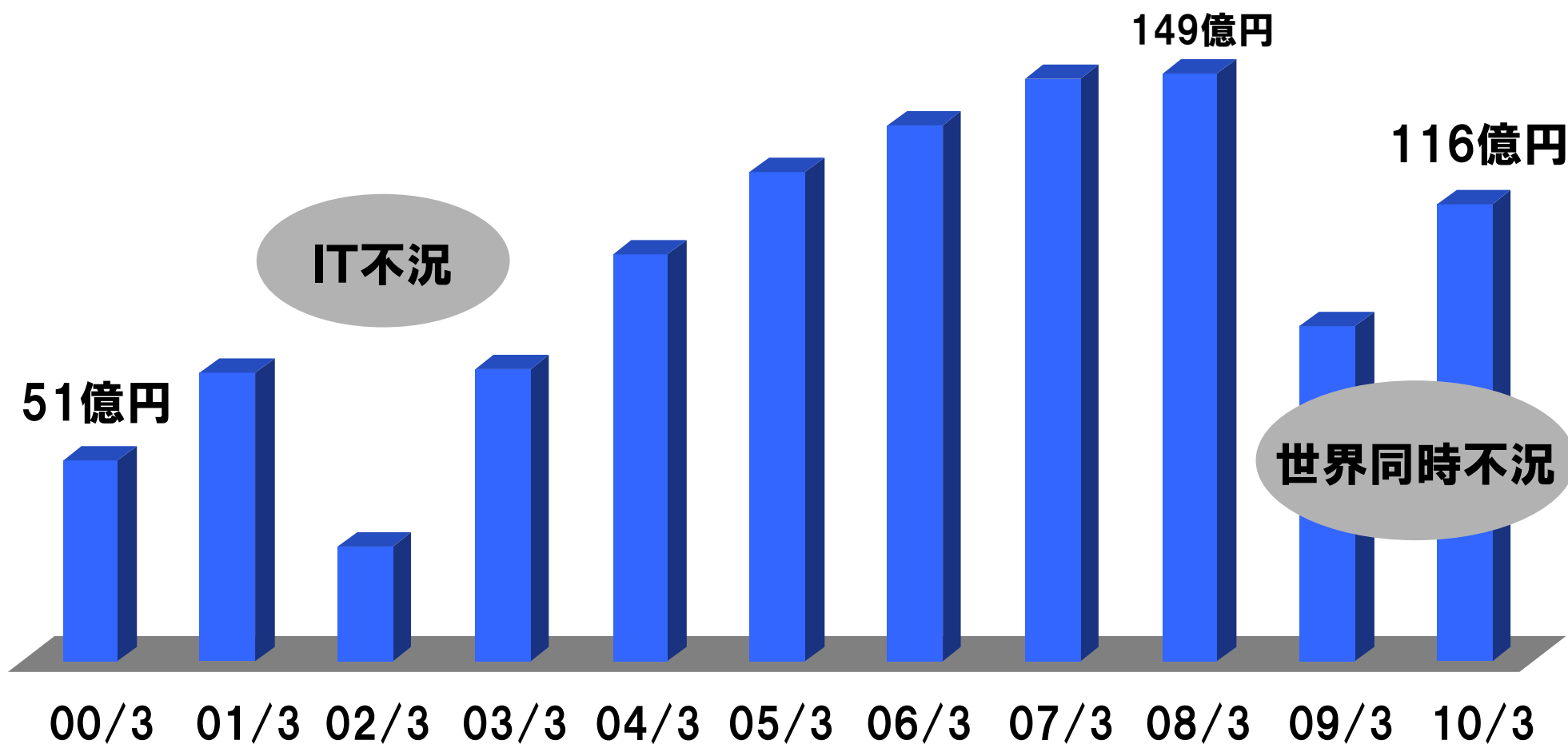


10年間で507億円増加、年平均成長率3.2%

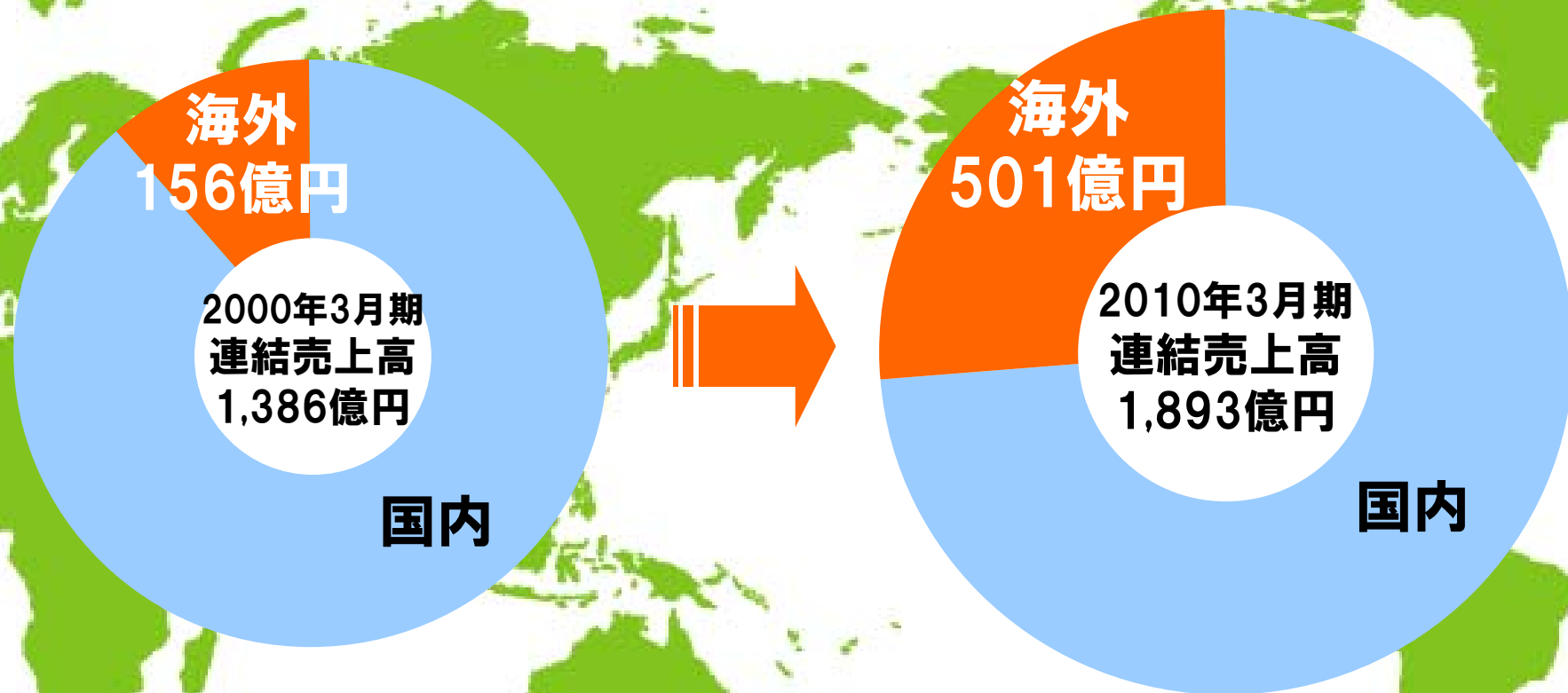


業績の推移／営業利益

10年間で65億円増加、年平均増加率8.5%



10年間で345億円増加、年平均成長率12.4%
(特にアジア地域売上高の年平均成長率は16.4%)

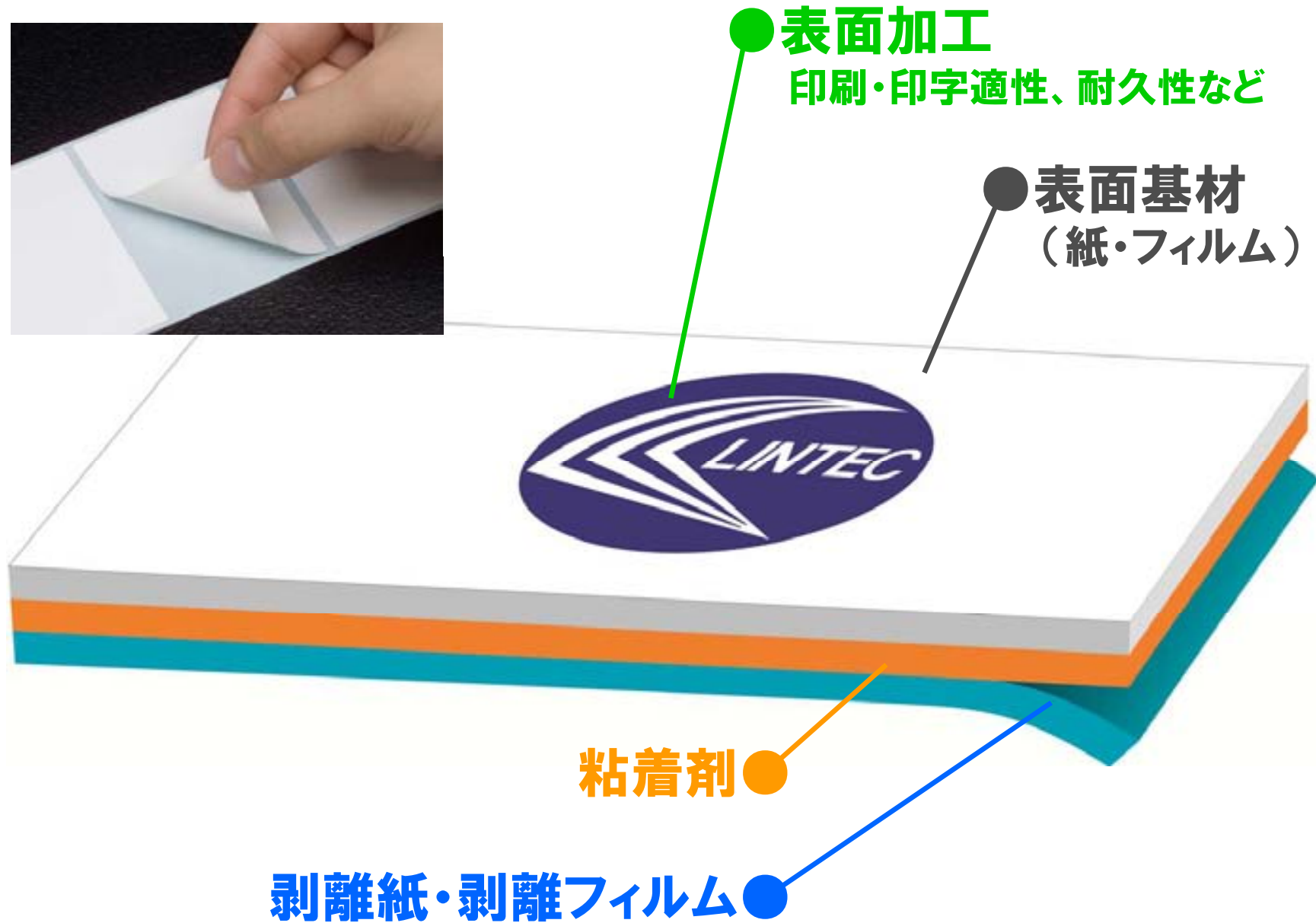


11.3%

海外売上高比率

26.5%

粘着製品の基本構成



トータルに自社技術で対応

基盤技術

1

粘着応用技術

2

表面加工技術

3

システム化技術

4

特殊紙製造技術



粘着関連製品



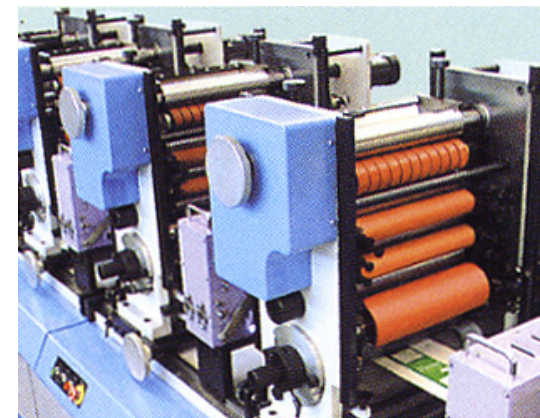
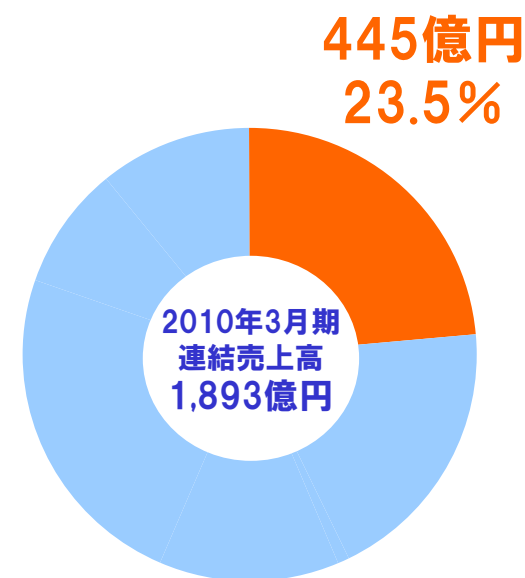
粘着素材
+
関連機器



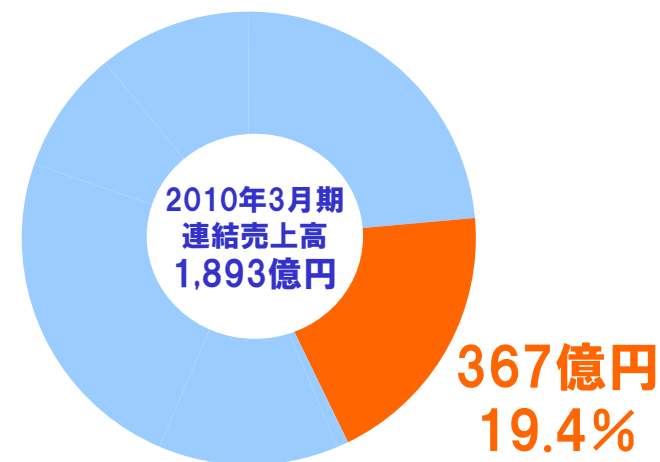
紙関連製品



- シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルム
 - 粘着剤によって、永久接着タイプ・再剥離タイプ・再貼付タイプに分けられる
 - 印刷適性・耐久性・耐熱性・耐水性・低温適性・曲面貼付性・寸法安定性・意匠性などに優れ、さまざまな用途や使用環境に対応
- ラベル印刷機など

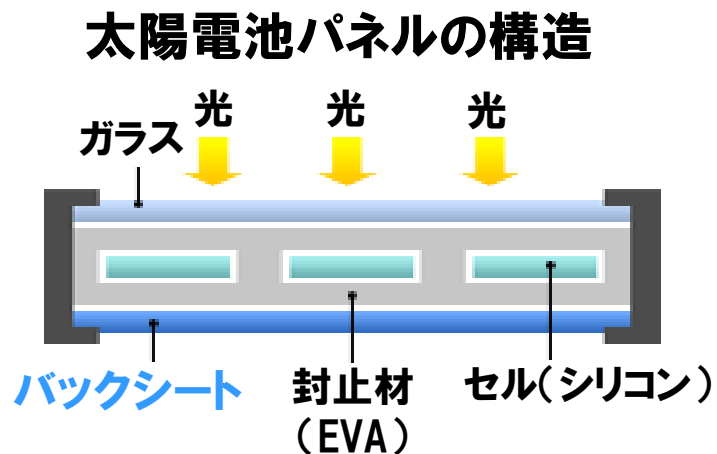


- 屋外看板・広告用フィルム
- 内装用化粧シート
- ウィンドーフィルム
- 太陽電池用バックシート
- 自動車用粘着製品
- 工業用粘着テープ
- バーコードプリンタ／バーコード用ラベル素材
- ラベリングマシン など

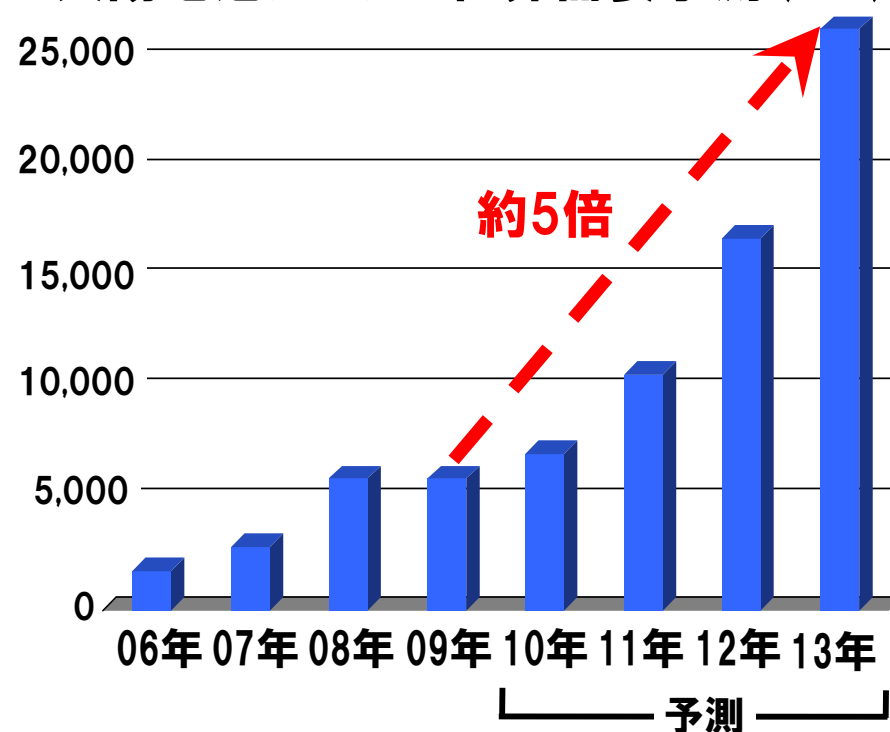


太陽電池用バックシート

- 太陽電池パネルの裏面を保護するシート
- 屋外使用への耐久性、発電効率向上のための高反射、電気絶縁性などが求められる
- 地球温暖化対策として、各国で導入推進策が図られており、今後も大きな成長が期待される



● 太陽電池システム世界需要予測 (MW)

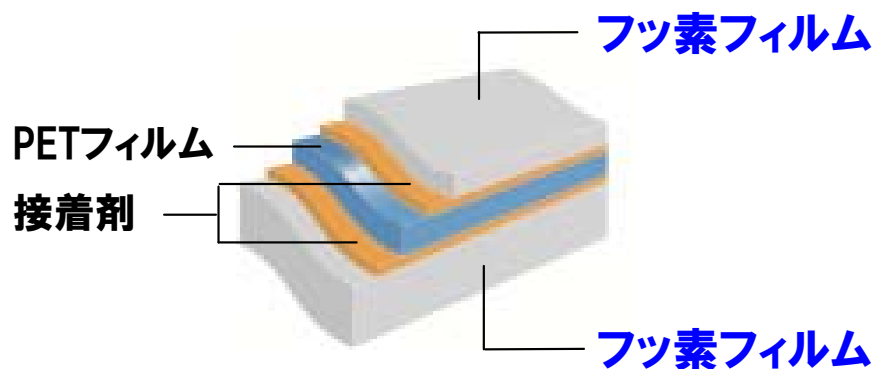


当社グループのバックシートの特徴

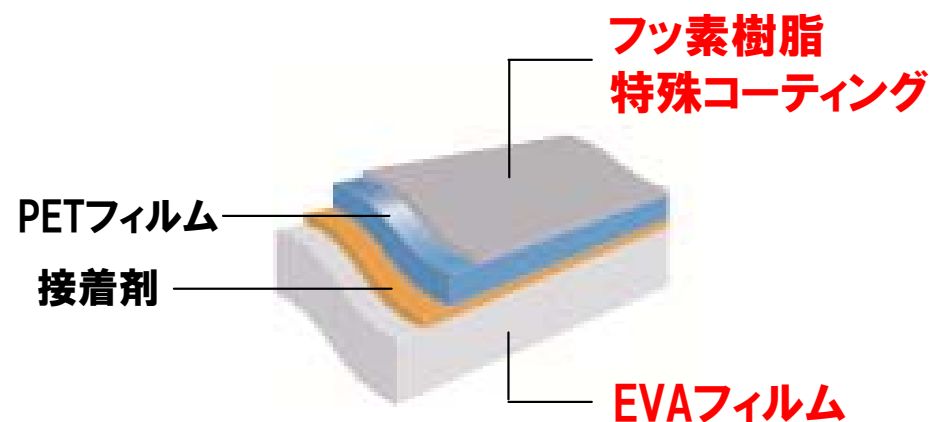
- 一般的に使用されるフッ素フィルムに代え、フッ素樹脂のコーティングとEVAフィルムを採用
- 耐久性、耐水性、電気絶縁性、封止材との接着性などに優れる
- 価格競争力に優れ、安定供給も可能



(他社品)



(当社グループ製品)



当社グループのバックシート供給体制



- 米国子会社のマディコ社で欧米向け、千葉工場と三島工場
国内・アジア向けを製造
- バックシートの需要拡大に応じて、今後も生産能力の増強を図る

●アルミホイール用保護フィルム



●ドアサッシ用塗装代替フィルム



独自の材料設計によって、
空気を抜けやすくし、貼付を容易に

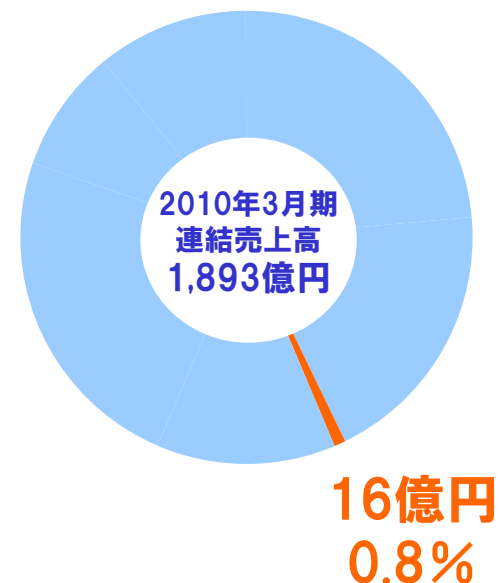


空気の入った状態

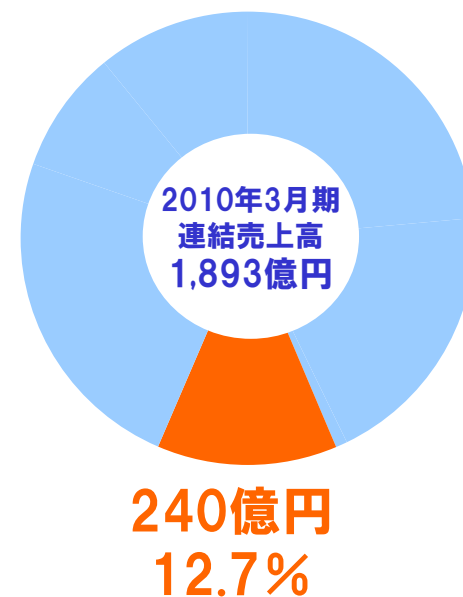


空気のない状態

- 経皮吸収型製剤
- 医療用粘着製品
- シート状化粧品
- 抗菌・防カビ剤
- 膨潤性経口フィルム製剤 など



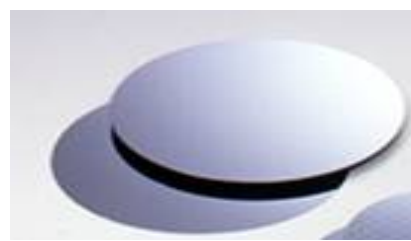
- 半導体関連テープ・関連装置
- 積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルム
- 薄型テレビ用光学機能性フィルム
- タッチパネル関連製品 など



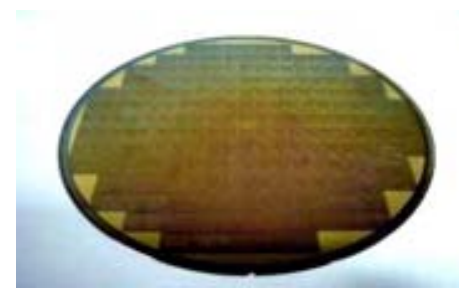
半導体チップの製造工程と当社製品

【前工程】

単結晶シリコン
インゴット



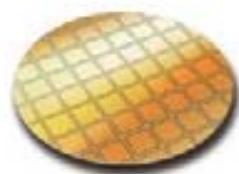
ウェハ



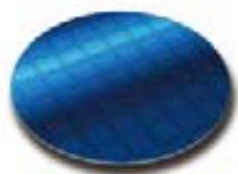
回路形成ウェハ

【後工程】

※当社テープ・装置を使用



回路形成
ウェハ



表面保護
テープ貼付



裏面研磨
(薄型化)



ダイシング
テープ貼付



表面保護
テープ剥離



ダイシング
(ウェハ切断)



テープへの
紫外線照射



ピックアップ



実装

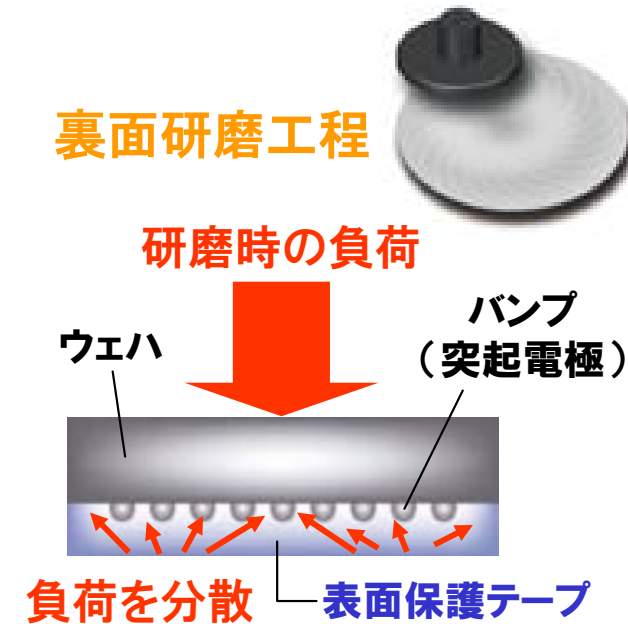


樹脂封止

● 極薄・ハイバンプウェハ対応表面保護テープ

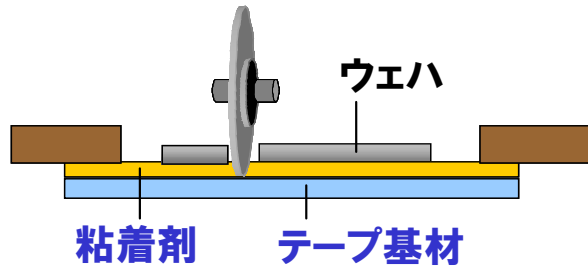
- ・特殊設計により、研磨後の薄型ウェハの反りを抑制
- ・回路面に形成されたバンプの凹凸にも、すき間なく貼ることができる、ウェハ表面の汚染を防止
- ・ウェハにかかる研磨時の負荷を分散して破損を抑制

裏面研磨工程



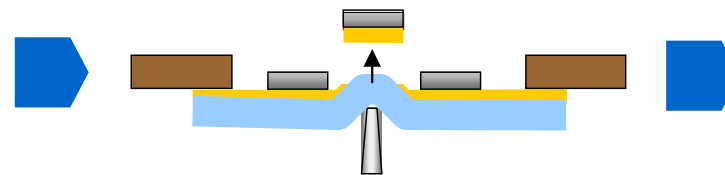
● ダイシング・ダイボンディングテープ

ダイシング(切断)工程



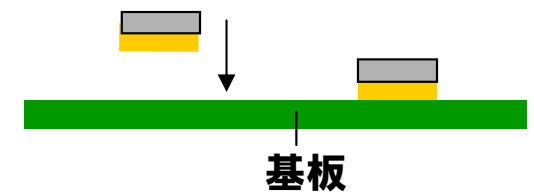
チップをしっかりと固定

ピックアップ工程



チップ裏面に粘着剤を転写

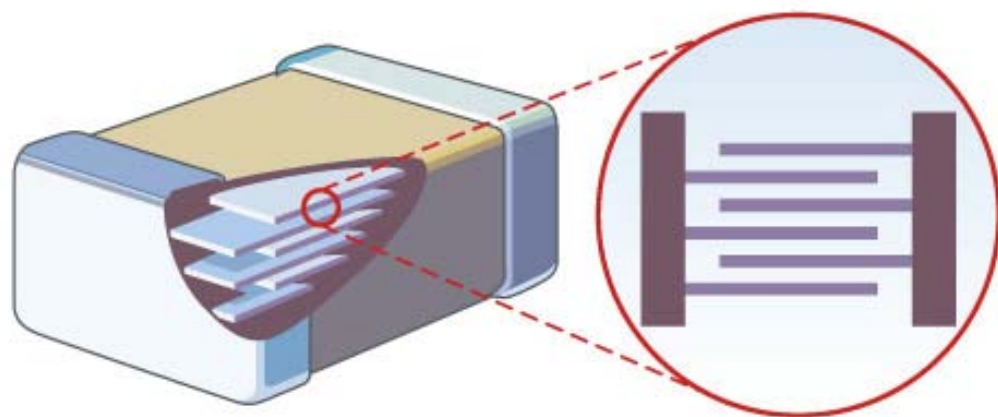
ダイボンディング(実装)工程



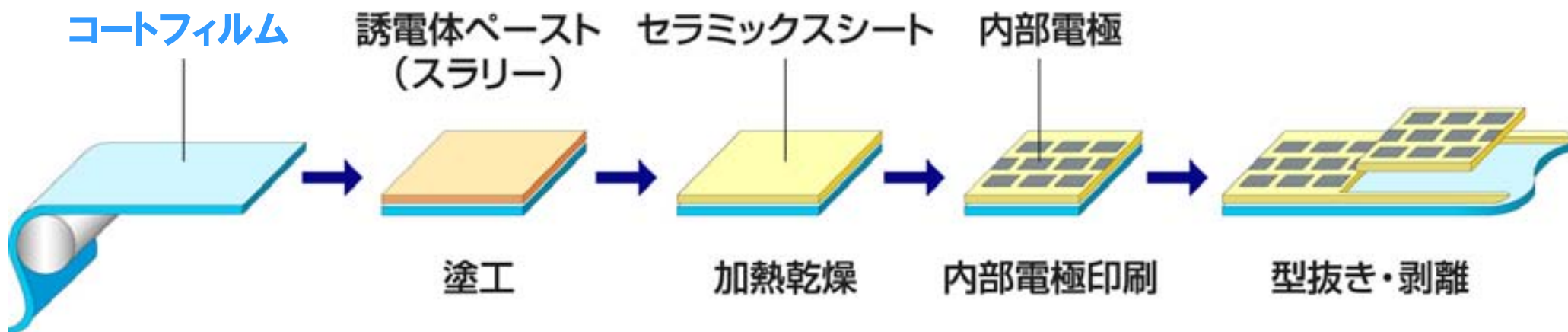
基板実装時の
接着剤塗布工程が不要に

積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルム

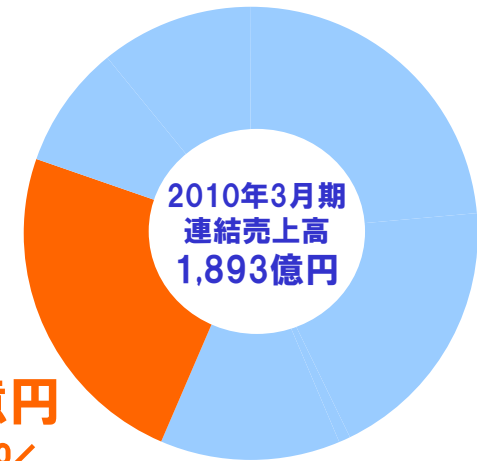
■積層セラミックコンデンサーの構造



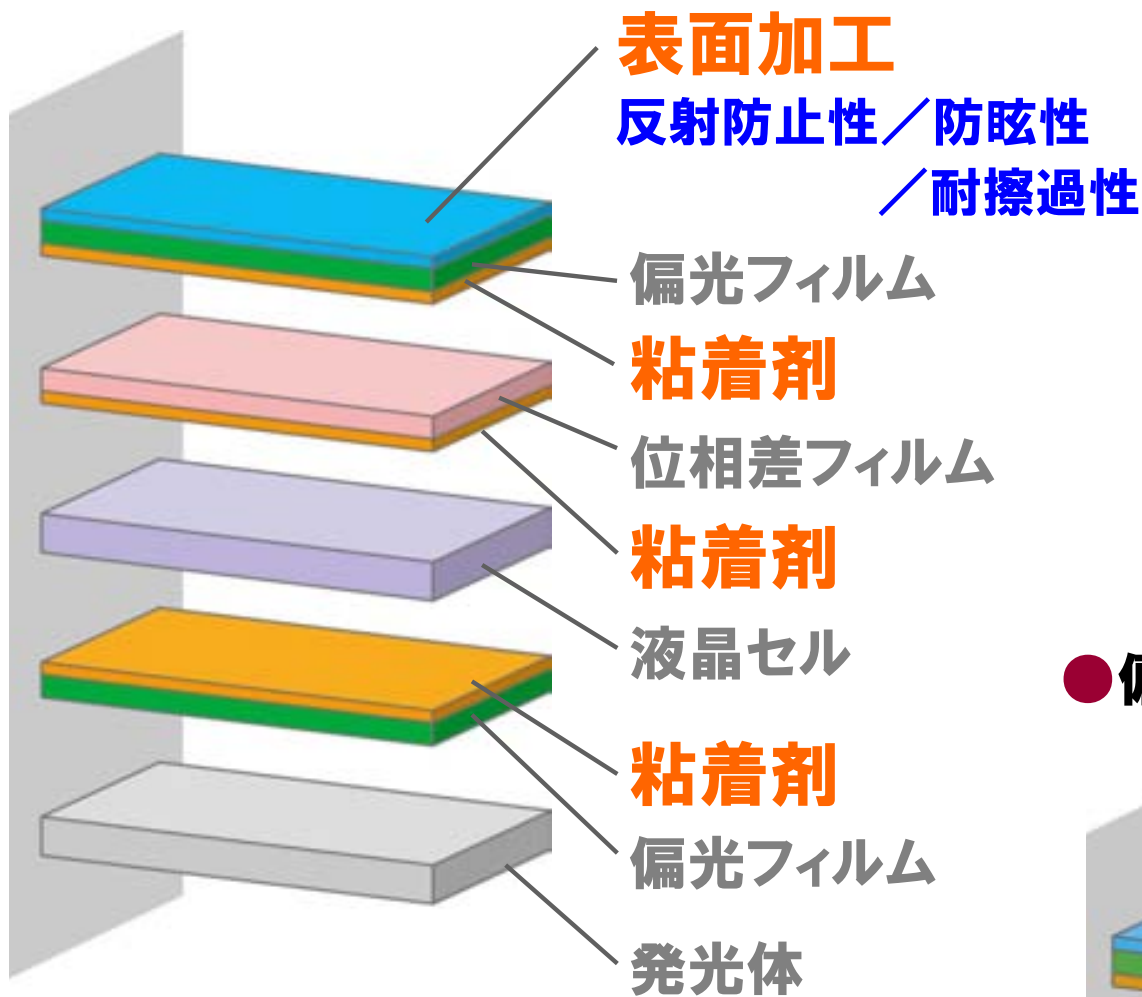
■製造工程と当社コートフィルム



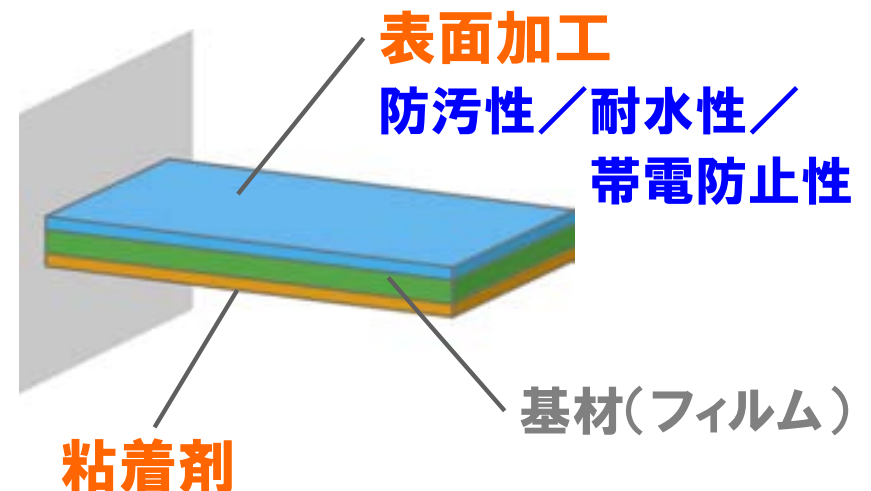
- 液晶用偏光・位相差フィルム / 粘着加工
- 液晶用偏光フィルム / 表面加工
- 偏光フィルム用保護フィルム など



液晶ディスプレイの構成

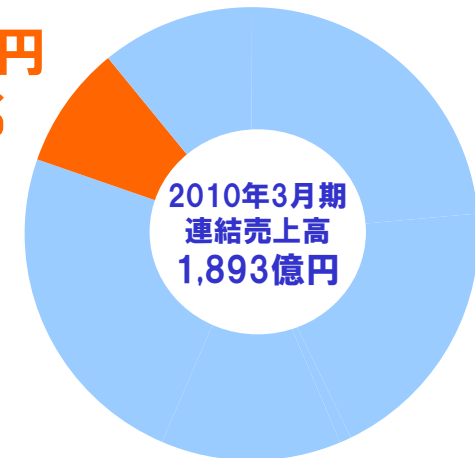


● 偏光フィルム用保護フィルム

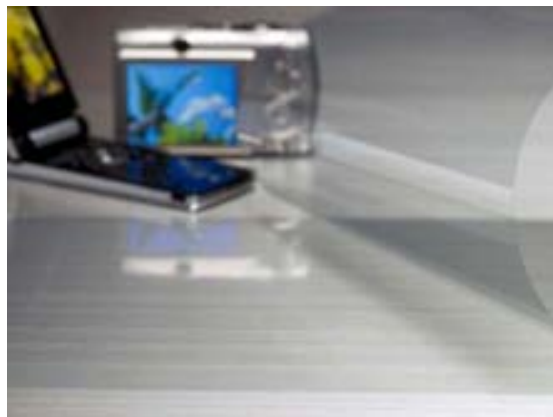
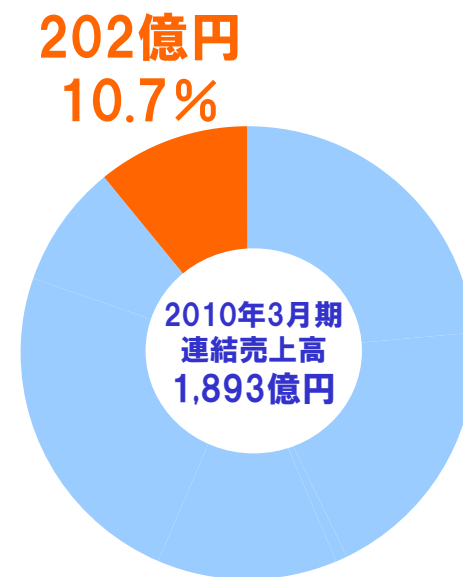


- カラー封筒用紙
- 色画用紙
- 無塵紙
- 高級紙製品用紙
- 高級印刷用紙 など

171億円
9.0%



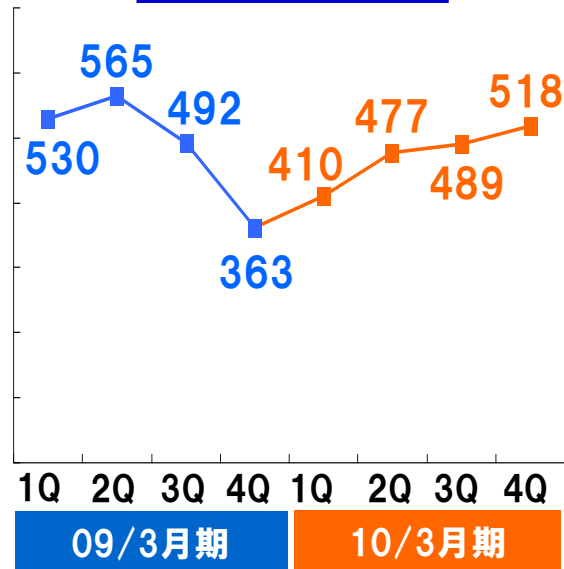
- 粘着製品用剥離紙・剥離フィルム
- 光学製品用剥離フィルム
- 合成皮革用工程紙
- 炭素繊維複合材料用工程紙 など



2010年3月期 連結業績の概要

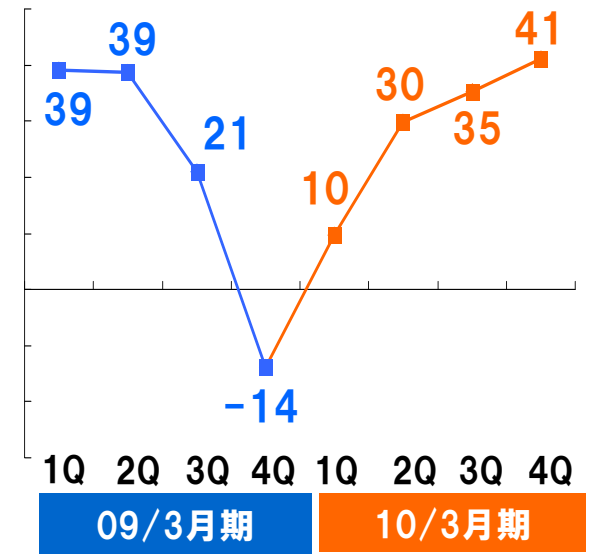
	(単位:億円)		
	10/3月期 実績	09/3月期 実績	増減 (増減率)
売上高	1,893	1,949	▲56 (▲2.8%)
営業利益	116	85	31 (36.2%)
経常利益	113	57	56 (99.8%)
当期純利益	73	34	39 (114.8%)

売上高

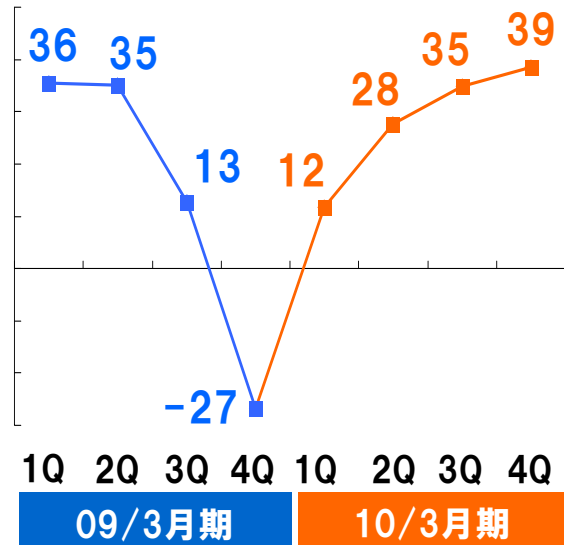


営業利益

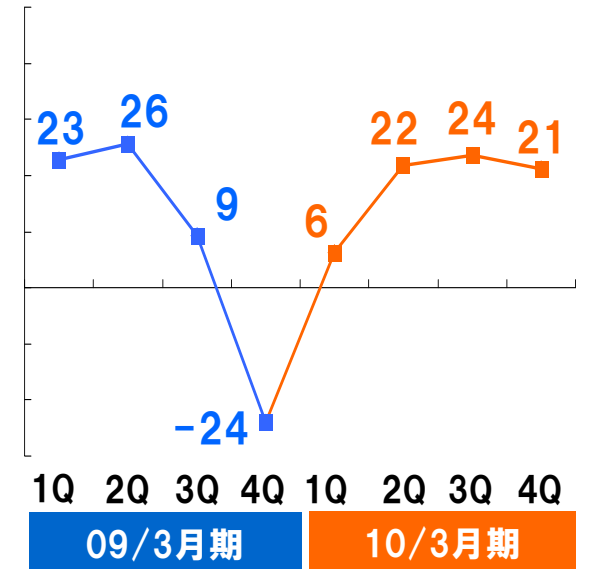
(単位:億円)



経常利益



当期純利益



2011年3月期通期 連結業績と事業部門別売上高の見通し

(単位:億円)

	11/3月期 見通し	10/3月期 実績	増減額 (増減率)
売上高	2,020	1,893	127 (6.7%)
営業利益	135	116	19 (16.6%)
経常利益	130	113	17 (15.0%)
当期純利益	92	73	19 (26.3%)

(単位:億円)

	11/3月期 見通し	10/3月期 実績	増減額 (増減率)
印刷・情報材 事業部門	464	445	19 (4.3%)
産業工材 事業部門	397	367	30 (8.2%)
ヘルスケア 事業部門	16	16	0 (0.0%)
アドバンス マテリアルズ 事業部門	264	240	24 (10.0%)
オプティカル材 事業部門	490	453	37 (8.2%)
洋紙 事業部門	174	171	3 (1.8%)
加工材 事業部門	215	202	13 (6.4%)

次なる飛躍への足固めの年

三つの重点課題

①収益基盤の強化

②業務改革の推進

③次なる成長への布石

●コスト削減活動の継続・推進

- ・固定費の削減
- ・グループSCMの最適化
- ・製造原価低減への取り組み強化

●新生産設備の導入と統廃合



次なる飛躍への足固めの年

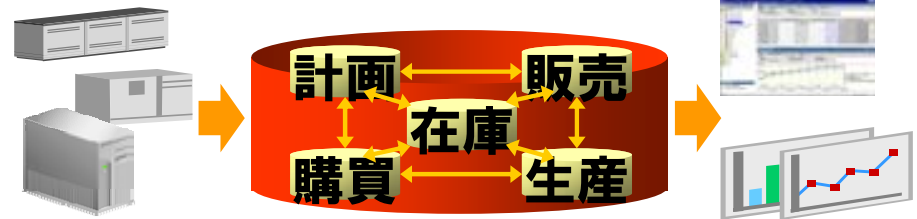
三つの重点課題

①収益基盤の強化

②業務改革の推進

③次なる成長への布石

- 情報基盤の整備
 - ・経営のスピードアップ
 - ・業務の標準化・効率化



- 生産部門の現場改革活動の推進

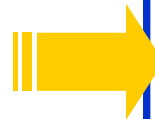
次なる飛躍への足固めの年

三つの重点課題

①収益基盤の強化

②業務改革の推進

③次なる成長への布石



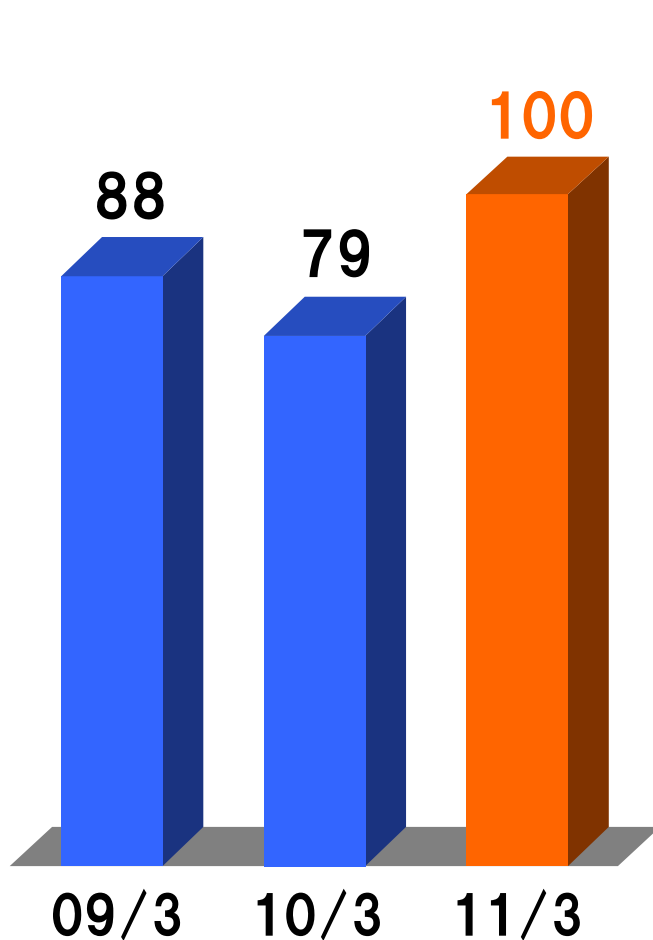
- アジア地域における成長戦略の構築
- 成長領域へのR&D集中投資
- M&A戦略の強化
- 全事業部門の連携・強化による市場の開拓と深耕
- 会社の成長を牽引するための人材戦略と育成



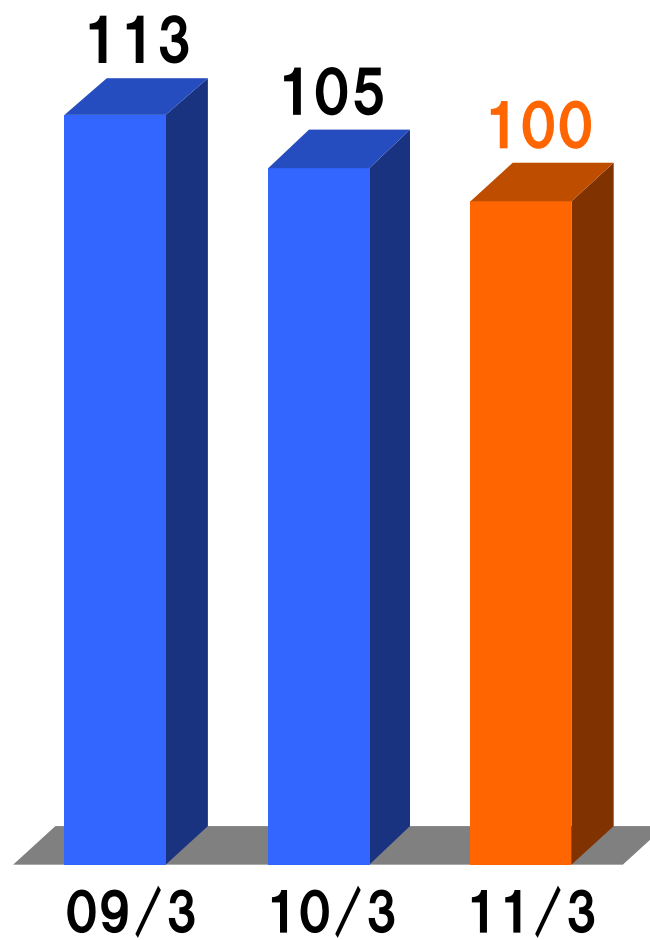
設備投資額・減価償却費・研究開発費

単位:億円 ■ 実績 ■ 見通し

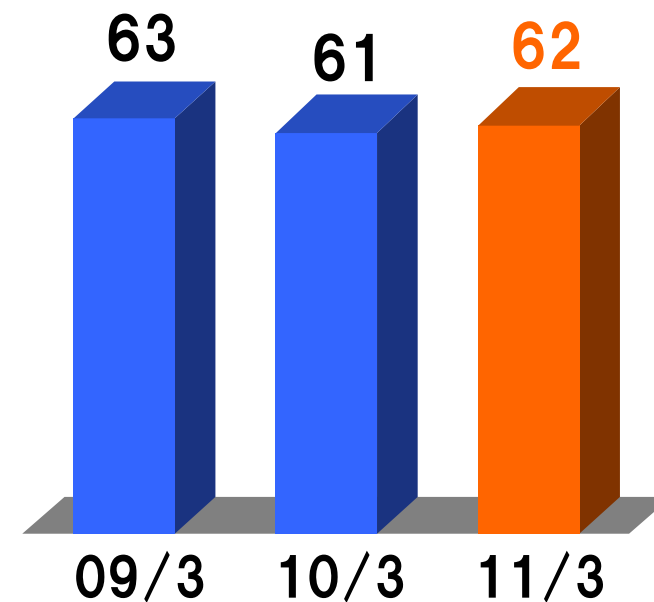
設備投資額



減価償却費



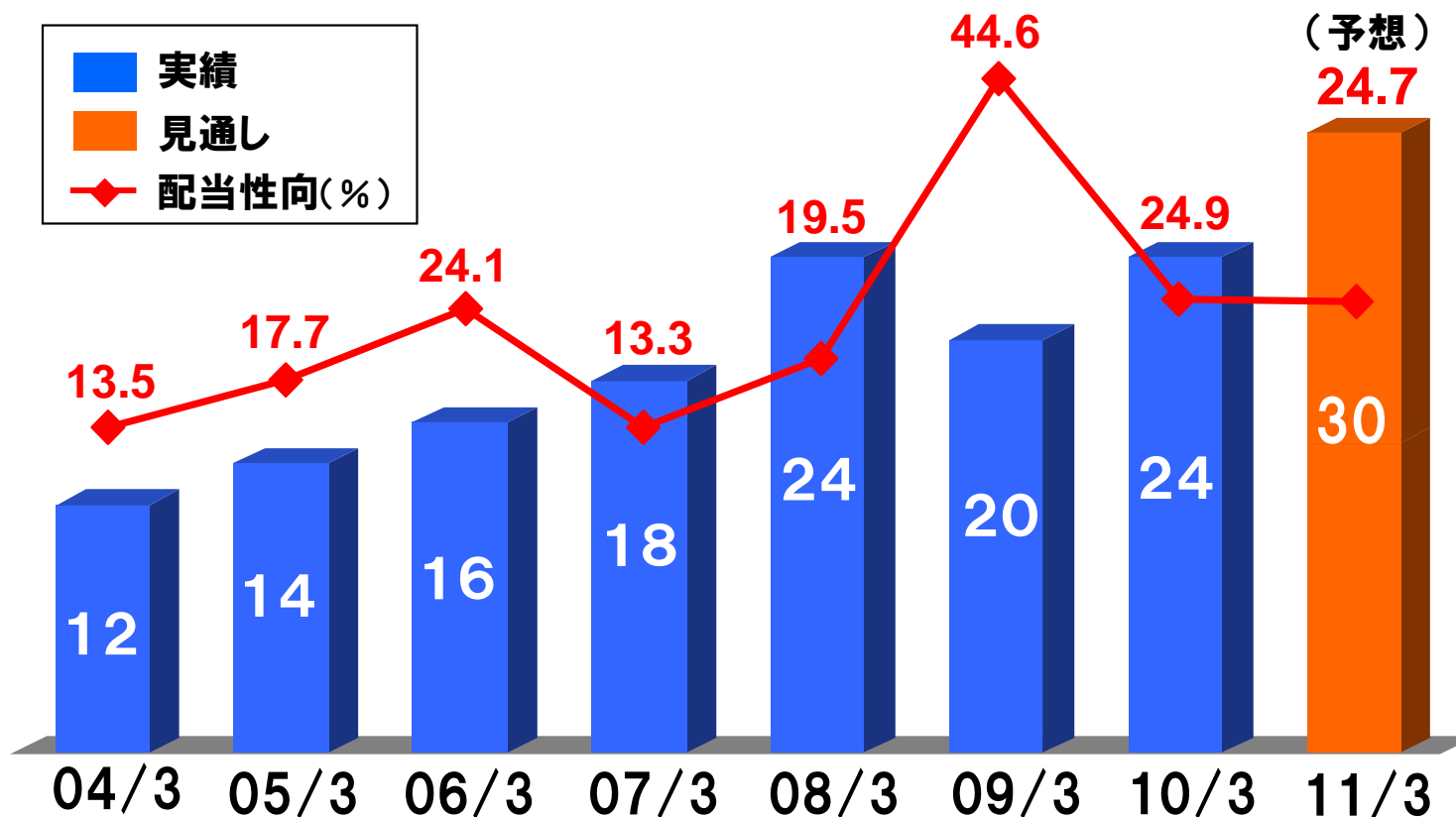
研究開発費



■配当方針

長期的な視野に立った事業収益の拡大並びに財務体質の強化を図るとともに、連結業績を考慮した配当を実施

●1株当たり配当金推移（円）



リンテック株式会社

証券コード:7966 (東証1部)

単元株式数:100株

自己資本比率: 61.7% (10/3)

ROE: 6.2% (10/3)

株価 1,607円 (7月6日終値)

時価総額:1,230億円

PER: 13.2倍 (11/3予想)

PBR: 1.01倍 (10/3実績)

本資料に掲載されている業績見通しに関する内容につきましては、本資料の作成日現在において想定できる経済情勢、市場動向および計画などに基づき作成したものであり、その内容の正確性を保証したり、将来の計画数値、施策の実現を確約したりするものではありません。実際の業績は、今後のさまざまな要因によって異なる可能性があります。

(お問い合わせ先) リンテック株式会社 広報・IR室

〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

TEL.03-5248-7741